



LEXCMGX

Laminate

Prepreg

R-151YE

R-141YE

高弾性・低熱膨張・
極薄対応半導体パッケージ基板材料

極薄材料により半導体パッケージの薄型化や、熱膨張が低いためサブストレートの低反りを実現

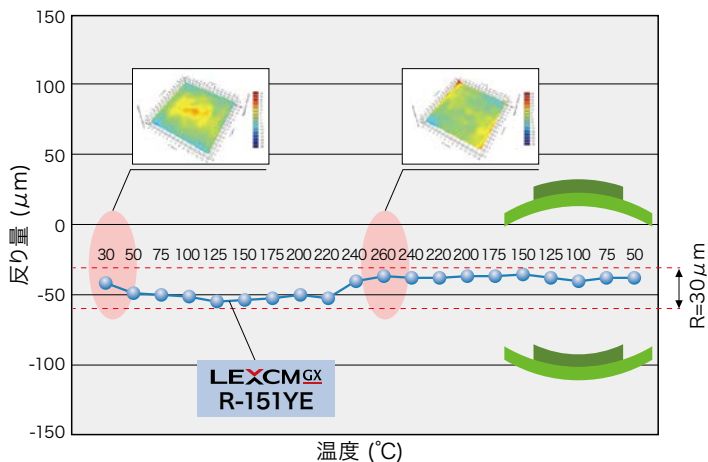
曲げ弾性率
25°C 33GPa

CTE x, y-axis
9ppm/°C

Tg(DMA) 270°C

用途
半導体パッケージ基板
CSP (DRAM, NAND/PMIC, Mini LED など)
FC-CSP (APU, RF-IC など)

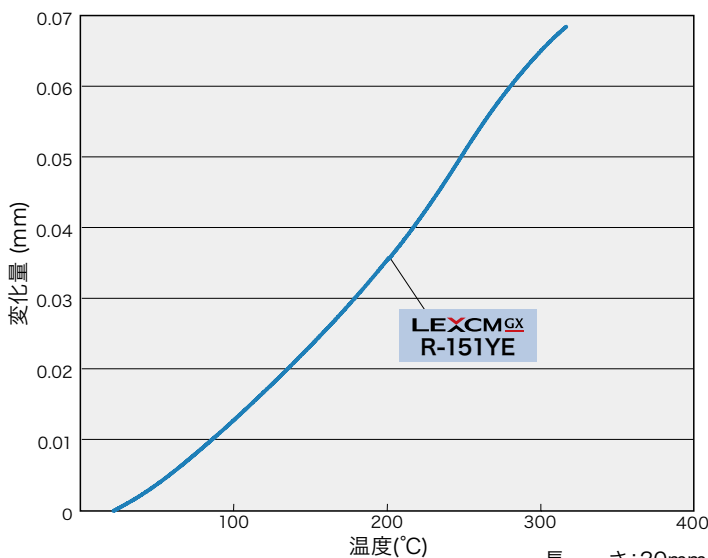
パッケージ基板反り評価結果(FBGA)



構成

FBGA	14×14 mm
チップサイズ	10×10×0.15 mm
基板厚さ	0.10 mm (コア 0.04mm)

熱膨張量(タテ方向)



長さ: 20mm
厚さ: 0.1mm
評価方法: TMA

一般特性

項目	試験方法	条件	単位	LEXCMGX R-151YE
ガラス転移温度(Tg)	DMA ^{※2}	A	°C	270
熱分解温度(Td)	TGA	A	°C	390
熱膨張係数(タテ方向)	社内法	A	ppm/°C	9
熱膨張係数(ヨコ方向)				9
熱膨張係数(厚さ方向)	IPC-TM-650 2.4.24	A		22 ^{※1}
				95 ^{※1}
曲げ弾性率	JIS C 6481	25°C	GPa	33 ^{※1}
		250°C		18 ^{※1}

試験片の厚さは0.1mmです。

※1 0.8mm ※2 引張りモードでの測定

商品のご採用にあたっては、当社webサイトより注意事項をご確認ください。

当社ハロゲンフリー材料は、JPCA-ES-01-2003などの定義によるものです。

上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。

industrial.panasonic.com/jp/electronic-materials

Panasonic Industry R-151YE

パナソニック インダストリー株式会社 電子材料事業部

© Panasonic Industry Co., Ltd. 2024/07